



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100617000
2010 年 7 月 2 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA/PWR SOIC(8/14 ピンD)パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan)	☐ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Test	☒ Site ☐ Process
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	HPA/PWR SOIC(8/14 ピンD)パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加 現行：TI-Mexico(メキシコ) 変更後：TI-Mexico(メキシコ), TI-Malaysia(マレーシア)	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	10 月上旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。尚、変更品の出荷につきましては、本通知の90日以降に予定いたしております。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)/PWR(パワーマネジメント) SOIC(8/14ピンD)パッケージ 一部製品の組立検査サイトについて、現行 TI-Mexico(メキシコ)サイトにおいて製造していますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Malaysia(マレーシア)サイトを追加する予定です。組立部材の変更は下記を参照下さい。TI-Malaysiaサイトにおいて、SOICパッケージ製品は認定されています。下記信頼性試験結果(2004年11月7日終了)を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立検査サイト	TI-Mexico(メキシコ)	TI-Mexico(メキシコ) TI-Malaysia(マレーシア)

	現行	追加認定
組立検査サイト	TI-Mexico	TI-Malaysia
チップ接着剤 部材番号	4147858	4042500

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
HPA00508D	SN65LBC180DR	TLC2272IDRG4	TLC555CDR	TPS40200DG4
HPA00508DR	SN65LBC180DRG4	TLC2274A1DR	TLC555CDRG4	TPS40200DR
HPA00516EDR	SN65LBC184DR	TLC2274A1DRG4	TLC5551DR	TPS40200DRG4
HPA00580EDR	SN65LBC184DRG4	TLC2274CDR	TLC5551DRG4	UCC25600D
HPA00894DR	SN65MLVD200ADR	TLC2274CDRG4	TLE20221DR	UCC25600DR
INA219A1DR	SN65MLVD200ADRG4	TLC22741DR	TLE20221DRG4	UCC25600DRG4
INA220A1DR	SN65MLVD206DR	TLC22741DRG4	TLV23721DR	UCC27324D
SN65HVD11DR	SN65MLVD206DRE4	TLC271CDR	TLV23721DRG4	UCC27324DG4
SN65HVD11DRG4	SN75HVD3082EDR	TLC271CDRG4	TLV23741DR	UCC27324DR
SN65HVD230DR	SN75HVD3082EDRG4	TLC272CDR	TLV23741DRG4	UCC27324DRG4
SN65HVD230DRG4	SN75LBC176DR	TLC272CDRG4	TLV2721DR	UCC27424D
SN65HVD251DR	SN75LBC176DRG4	TLC2721DR	TLV2721DRG4	UCC27424DG4
SN65HVD251DRG4	SN75LBC180DR	TLC2721DRG4	TLV2741DR	UCC27424DR
SN65HVD3082EDR	SN75LBC180DRG4	TLC27L2CDR	TLV2741DRG4	UCC27424DRG4
SN65HVD3082EDRG4	SN75LBC184DR	TLC27L2CDRG4	TLV2762CDR	UCC37324D
SN65HVD485EDR	SN75LBC184DRG4	TLC27L21DR	TLV2762CDRG4	UCC37324DG4
SN65HVD485EDRG4	TLC2272A1DR	TLC27L21DRG4	TPA6111A2DR	UCC37324DR
SN65LBC176ADR	TLC2272A1DRG4	TLC3702CDR	TPA6111A2DRG4	UCC37324DRG4
SN65LBC176ADRG4	TLC2272CDR	TLC3702CDRG4	TPA6113A2DR	
SN65LBC176DR	TLC2272CDRG4	TLC37021DR	TPA6113A2DRG4	
SN65LBC176DRG4	TLC22721DR	TLC37021DRG4	TPS40200D	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地コード(ラベル箇所:22L, 23L)及び製品捺印が下記の様になる予定です。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)	組立国コード(23L)
現行	TI-Mexico	ASO: MEX	ACO: MEX
追加認定	TI-Malaysia	ASO: MLA	ACO: MYS



図1 出荷ラベルの例

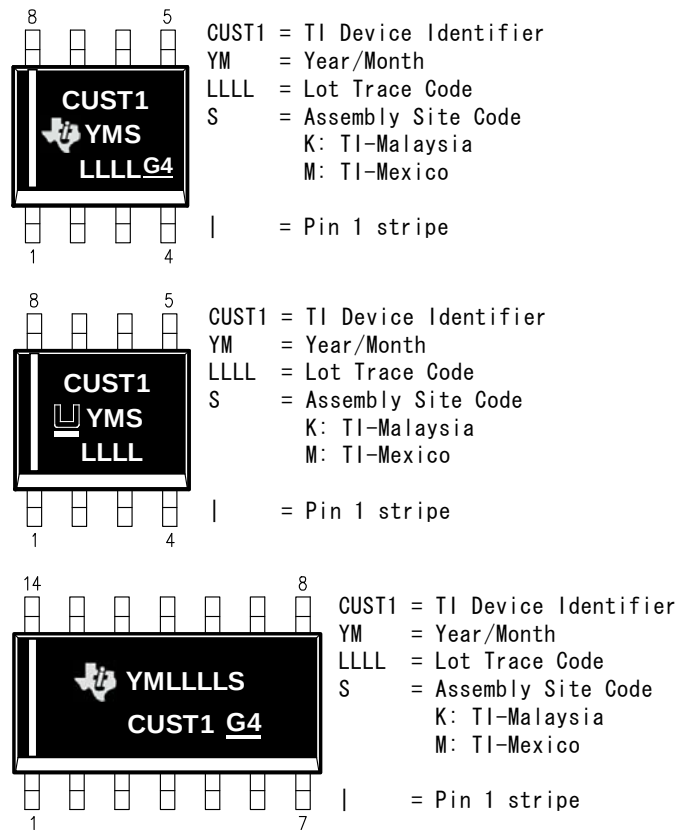


図2 捺印表示の例 (8ピンD及び14ピンDパッケージ)

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010 年 6 月	終了	2010 年 8 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device-1	Device-2	Device-3	
Qual Device:	INA220AIDR	TLC271CDR	TLC555IDR	
Die Size (mm):	2.23 X 1.02	1.42 X 1.24	1.27 X 1.65	
Die Protective Coating:	SiON (8KA)	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	TI Malaysia	TI Malaysia	
Package/Code/Pins:	SOIC/D/14	SOIC/D/8	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	4042500	4042500	
Mold Compound:	4205694	4205694	4205694	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	0.96 Mil Dia., Au	0.96 Mil Dia., Au	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Device-1	Device-2	Device-3
Electrical Characterization	Over Temp	-	10	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Manufacturability (Test)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Yield Evaluation	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010 年 6 月	終了	2010 年 8 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device-1	Device-2	Device-3	
Qual Device:	TPS40200D	UCC25600D	UCC27324D	
Die Size (mm):	1.45 X 1.41	1.34 X 1.18	1.52 X 1.56	
Die Protective Coating:	11.5KAN	10KAN	11.5KAN	
Assembly Site:	TI Malaysia	TI Malaysia	TI Malaysia	
Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	SOIC/D/8	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	4042500	4042500	
Mold Compound:	4205694	4205694	4205694	
Bond Wire:	1.31 Mil Dia., Au	0.96 Mil Dia., Au	0.96 Mil Dia., Au	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	
Device ID:	Device-4	Device-5	-	
Qual Device:	UCC27424D	UCC37324D	-	
Die Size (mm):	1.52 X 1.56	1.52 X 1.56	-	
Die Protective Coating:	11.5KAN	11.5KAN	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	TI Malaysia	-	
Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	SOIC/D/8	-	
Mount Compound:	4042500	4042500	-	
Mold Compound:	4205694	4205694	-	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	0.96 Mil Dia., Au	-	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Device-1	Device-2	Device-3
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Manufacturability (Test)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Device-4	Device-5	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	-
Manufacturability (Test)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	-

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2085D	Die Size (mils):	54 X 72 (dual die)	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	2.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L- 1/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	-
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	-
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	SN75976A1DL	Die Size (mils):	301 X 122	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DL/56	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L- 3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 240 Hours	116/0	116/0	116/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2211ADB	Die Size (mils):	118 X 63	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DB/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L- 1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	40/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	40/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2201DB	Die Size (mils):	142 X 204	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DB/30	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	2.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L- 1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	40/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	40/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	BQ3285ESS	Die Size (mils):	88 X 105	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DBQ/24	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L- 2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -2/260C				